

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
19. Februar 2004 (19.02.2004)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 2004/014636 A1

(51) Internationale Patentklassifikation⁷: **B29C 67/00**

(72) Erfinder; und

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP2003/007536

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): **HEUGEL, Martin**
[DE/DE]; Eichestrasse 9, 86899 Landsberg-Pitzling
(DE).

(22) Internationales Anmeldedatum:
11. Juli 2003 (11.07.2003)

(74) Anwalt: **HOFER, Dorothea**; Prüfer & Partner GbR,
Harthauser Strasse 25d, 81545 München (DE).

(25) Einreichungssprache: Deutsch

(81) Bestimmungsstaaten (national): JP, US.

(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch

(84) Bestimmungsstaaten (regional): europäisches Patent (AT,
BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR,
HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR).

(30) Angaben zur Priorität:
102 35 427.8 2. August 2002 (02.08.2002) DE

Erklärung gemäß Regel 4.17:

— Erfindererklärung (Regel 4.17 Ziffer iv) nur für US

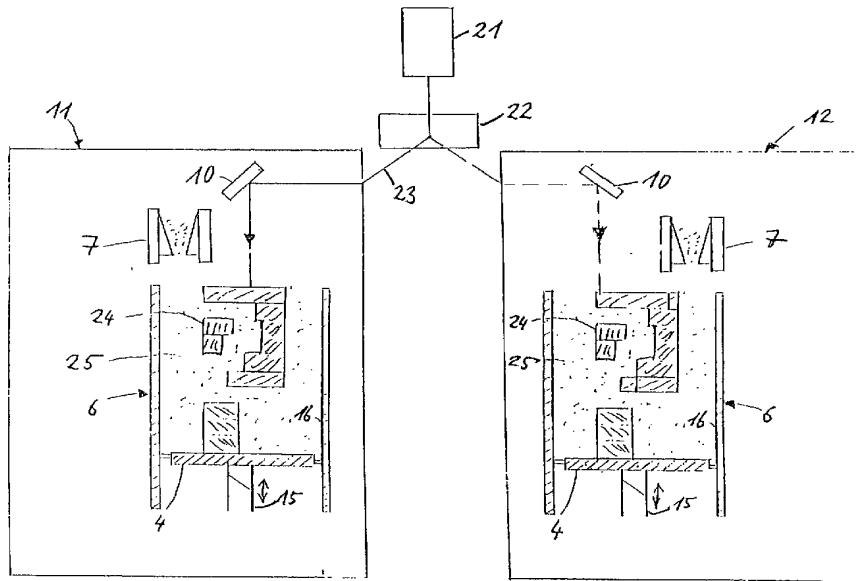
Veröffentlicht:

— mit internationalem Recherchenbericht

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: DEVICE AND METHOD FOR THE PRODUCTION OF THREE-DIMENSIONAL OBJECTS BY MEANS OF A GENERATIVE PRODUCTION METHOD

(54) Bezeichnung: VORRICHTUNG UND VERFAHREN ZUM HERSTELLEN VON DREIDIMENSIONALEN OBJEKten
MITTELS EINES GENERATIVEN FERTIGUNGSVERFAHRENS



(57) Abstract: Disclosed are a device and a method for the layer-by-layer, generative production of three-dimensional objects. Several objects are produced in parallel in different processing chambers (11, 12, 13, 14) by successively applying layers of a structural material (25), whereupon a layer is solidified or the layer is bonded with the previously applied layer by means of radiation. Said radiation is supplied to one part of the processing chambers by a source of radiation (21) that is disposed outside the processing chambers while a layer is applied in the other part of the processing chambers.

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

WO 2004/014636 A1



Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

(57) Zusammenfassung: Es werden eine Vorrichtung und ein Verfahren zur schichtweisen, generativen Herstellung von dreidimensionalen Objekten vorgesehen. Mehrere Objekte werden parallel in verschiedenen Prozesskammern (11, 12, 13, 14) mittels sukzessiven Auftrags von Schichten eines Aufbaumaterials (25) und anschliessendem Verfestigen einer Schicht bzw. Verbinden der Schicht mit der zuvor aufgetragenen Schicht mittels Strahlung hergestellt. Die Strahlung wird von einer ausserhalb der Prozesskammern angeordneten Strahlungsquelle (21) einem Teil der Prozesskammern zugeführt, während in dem anderen Teil der Prozesskammern ein Schichtauftrag stattfindet.

Vorrichtung und Verfahren zum Herstellen von dreidimensionalen Objekten mittels eines generativen Fertigungsverfahrens

Die vorliegende Erfindung betrifft eine Vorrichtung und ein Verfahren zum Herstellen von dreidimensionalen Objekten nach dem Oberbegriff des Patentanspruchs 1 bzw. des Patentanspruchs 13.

Bei generativen Fertigungsverfahren, wie z. B. dem Selektiven Lasersintern, dem selektiven Laserschmelzen, der Stereolithographie, dem 3D-Printing, werden dreidimensionale Objekte schichtweise hergestellt, indem Schichten eines Aufbaumaterials aufgetragen und durch selektives Verfestigen an den dem Querschnitt der Objekte entsprechenden Stellen miteinander verbunden werden.

Ein derartiges Verfahren und eine derartige Vorrichtung sind beispielsweise aus der EP 0 734 842 bekannt, die das selektive Lasersintern von pulverförmigem Aufbaumaterial beschreibt. Dort wird eine erste Schicht eines pulverförmigen Materials auf einen absenkbaren Träger aufgebracht und an den dem Objekt entsprechenden Stellen mit einem Laser bestrahlt, so daß

das Material dort zusammensintert. Danach wird der Träger abgesenkt und es wird auf diese erste Schicht eine zweite Schicht aufgebracht und wiederum selektiv gesintert, die dabei mit der ersten Schicht verbunden wird. Dadurch wird das Objekt schichtweise gebildet. Während des Auftragens einer neuen Schicht findet keine Bestrahlung statt. Dadurch wird der Laser als eines der kostenintensivsten Elemente der Lasersinteranlage nicht wirtschaftlich optimal genutzt und die Produktivität der Vorrichtung wird durch Bestrahlungspausen gesenkt. Hinzu kann ein Zeitverlust durch Aufheizen, Abkühlen und andere Verfahrensschritte treten.

Ferner ist es bei einer derartigen Vorrichtung bekannt, mehrere Objekte parallel aufzubauen, wenn diese in den Bauraum passen.

Sollen mehr Bauteile gleichzeitig gefertigt werden, als in den Bauraum passen, so ist dies grundsätzlich durch den parallelen Betrieb mehrerer solcher Vorrichtungen möglich, allerdings ist dies mit hohen Investitionskosten verbunden.

Eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es daher, eine Vorrichtung und ein Verfahren bereitzustellen, durch die auf kostengünstige Weise die Produktivität und Wirtschaftlichkeit bei der schichtweisen, generativen Herstellung von dreidimensionalen Objekten erhöht werden kann.

Die Aufgabe wird gelöst durch eine Vorrichtung nach Anspruch 1 und ein Verfahren nach Anspruch 13.

Weiterbildungen der Erfindung sind in den Unteransprüchen gekennzeichnet.

Weitere Merkmale und Zweckmäßigkeiten der Erfindung ergeben sich aus der Beschreibung von Ausführungsbeispielen anhand der Figuren. Von den Figuren zeigen:

Fig. 1 eine schematische Seitenansicht einer Vorrichtung gemäß einer ersten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung;

Fig. 2 eine schematische Darstellung einer Vorrichtung gemäß einer zweiten Ausführungsform der Erfindung;

Fig. 3 eine schematische Darstellung einer Vorrichtung gemäß einer Abwandlung der zweiten Ausführungsform der Erfindung;

Fig. 4 eine schematische Darstellung eines Verfahrensablaufs gemäß einer zweiten Ausführungsform der Erfindung; und

Erste Ausführungsform

Fig. 1 zeigt eine Querschnittsansicht einer Lasersinteranlage als Beispiel einer Vorrichtung zur schichtweisen Herstellung von dreidimensionalen Objekten aus einem mittels elektromagnetischer Strahlung verfestigbaren Aufbaumaterial gemäß einer ersten Ausführungsform der Erfindung. Die Vorrichtung weist zwei Prozeßkammern 11 und 12 auf, in denen jeweils Objekte hergestellt werden. Dabei kann es sich um zwei voneinander räumlich separate Prozeßkammern handeln oder aber um eine Doppelkammer, bei der jeder Teilbereich eine eigene Prozeßkammer darstellt. Jede der Prozeßkammern weist einen Baubehälter 6 mit einer Wandung 16 und einer Bauplattform 4 auf.

Die Bauplattform 4 ist mit einem Vertikalantrieb 15 verbunden, welcher eine Auf- und Abbewegung der Bauplattform 4 relativ zu dem Baubehälter in vertikaler Richtung ermöglicht.

Über dem Baubehälter 6 ist eine Materialauftragevorrichtung 7 zum Aufbringen des auf die Bauplattform 4 aufzubringenden Sinterpulvers angeordnet. Oberhalb der Materialauftragevorrichtung 7 ist eine Ablenkeinheit 10 angeordnet, die geeignet ist, einen gerichteten Strahl elektromagnetischer Strahlung, insbesondere Laserstrahlung auf beliebige Orte innerhalb einer aufgetragenen Schicht zu richten. Vorzugsweise handelt es sich bei der Ablenkeinheit 10 um einen xy-Scanner oder einen Plotter.

Wie in Fig. 1 dargestellt, ist eine Strahlungsquelle 21 in Form eines Lasers außerhalb der Prozeßkammern 11 und 12 angeordnet. Der ausgesandte Laserstrahl wird über eine Umschaltseinrichtung 22 entweder der einen Prozeßkammer 11 oder der anderen Prozeßkammer 12 zugeführt. Die Umschalteinrichtung 22 ist für den Fall, daß es sich bei der Strahlungsquelle 21 um einen Laser mit fasertransmissionsgeeigneten Eigenschaften handelt, z.B. einen NdYAG Laser, als Strahlweiche ausgebildet. Hierzu wird der Strahlweiche der Laserstrahl über eine Lichtleitfaser oder ein Lichtleitkabel zugeführt und über wahlweise mit diesem verbindbare Lichtleitfasern bzw. Lichtleitkabel an die einzelnen Prozeßkammern weitergeleitet. So mit sind die Prozeßkammern über Lichtleitfasern bzw. Lichtleitkabel jeweils fest mit dem Laser verbunden. Die Umschaltseinrichtung 22 kann aber auch als schaltbares optisches Element, insbesondere als ein Spiegel ausgebildet sein, wobei der Laserstrahl frei propagiert. Ferner zeigt Fig. 1 ein gebildetes Objekt 24, das von nicht verfestigtem Pulver 25 umgeben ist.

In einer Abwandlung ist eine Strahlteilereinrichtung vorgesehen, z.B. in Form eines regelbaren optischen Elements, die es erlaubt, den Strahl aus der Strahlungsquelle zu teilen und gleichzeitig beiden Kammern zuzuführen.

Die Vorrichtung der ersten Ausführungsform gestattet es, eine Strahlungsquelle für zwei verschiedene Prozeßkammern zu nutzen, was mehrere Vorteile für die Herstellung einer großen Stückzahl von Bauelementen mit sich bringt:

Wird nicht jede Prozeßkammer mit einer eigenen Strahlungsquelle versehen, führt dies zu einem deutlich geringeren Investitionsaufwand für die Erhöhung der Anzahl der Prozeßkammern.

Die Entkopplung von Strahlungsquelle und Prozeßkammer gestattet geringere Sicherheitsaufwendungen bei der Ausgestaltung der Prozeßkammer.

Durch die Entkopplung von Strahlungsquelle und Prozeßkammer ist der Platzbedarf für eine Prozeßkammer geringer.

Im Betrieb werden in den beiden Prozeßkammern 11, 12 zeitgleich Objekte hergestellt. Dabei wird der Laser 21 alternierend mit jeder der beiden Prozeßkammern 11, 12 verbunden. Insbesondere wird in der einen Prozeßkammer eine zuvor aufgetragene Schicht belichtet, während zeitgleich in der anderen Prozeßkammer auf eine zuvor selektiv bestrahlte Schicht eine neue Schicht aufgebracht wird und gegebenenfalls für die Bestrahlung vorbereitet wird, z.B. durch Vorheizung.

Das Verfahren gestattet eine gegenüber dem herkömmlichen Verfahren effektivere Nutzung der Strahlungsquelle. Da die Strahlungsquelle jeweils während der Zeit des Schichtauftrags in einem Baubehälter in dem anderen Baubehälter für eine Belichtung benutzt wird, erhöht sich ihr Auslastungsgrad beträchtlich.

Zweite Ausführungsform

Die Vorrichtung gemäß einer zweiten Ausführungsform unterscheidet sich von jener der ersten Ausführungsform darin, daß eine einzige Strahlungsquelle vier Prozeßkammern zugeordnet ist. Diese können entweder in Form von räumlich voneinander getrennten Einzelkammern oder als Teilbereiche von zwei Doppelkammern oder einer Vierfachkammer vorliegen.

Fig. 2 zeigt schematisch eine Vorrichtung gemäß einer zweiten Ausführungsform der Erfindung. Wie aus Fig. 2 ersichtlich ist, ist der Laser 21 über eine Umschalteinrichtung 224 mit jeweils einer der Prozeßkammern 11, 12, 13, 14 verbindbar. Alternativ dazu kann, wie in Fig. 3 dargestellt, jeweils zwei Prozeßkammern eine Umschalteinrichtung 222a bzw. 222b zugeordnet sein, deren Eingang mit einem Ausgang einer der Strahlungsquelle 21 nachgeschalteten Umschalteinrichtung 22 verbunden ist.

Fig. 4 zeigt ein Ablaufschema eines Verfahren gemäß einer zweiten Ausführungsform der Erfindung. Wie in der oberen Hälfte von Fig. 4 dargestellt, wird in den Prozeßkammern 11 und 12 zeitgleich ein Bauvorgang durchgeführt. Bei einem Aufbau gemäß Fig. 3 leitet hierzu die Umschalteinrichtung 22 die Strahlung der den Prozeßkammern 11 und 12 zugeordneten Umschalteinrichtung 222a zu. Die Umschalteinrichtung 222a führt

dann die Strahlung alternierend jeder der beiden Prozeßkammern 11 und 12 zu. Insbesondere wird in der einen Prozeßkammer eine zuvor aufgetragene bzw. vorbereitete Schicht belichtet, während zeitgleich in der anderen Prozeßkammer auf eine zuvor selektiv belichtete Schicht eine neue Schicht vorbereitet wird. Während des Bauvorgangs in den beiden Prozeßkammern 11 und 12 werden in den beiden anderen Prozeßkammern 13 und 14 fertig gebaute Objekte den Prozeßkammern entnommen und ein neuer Bauvorgang in den Prozeßkammern vorbereitet.

Wie in der unteren Hälfte von Fig. 4 dargestellt, wird nach Beendigung des Bauvorgangs in den Prozeßkammern 11 und 12 ein neuer Bauvorgang in den Prozeßkammern 13 und 14 durchgeführt, während in den beiden Prozeßkammern 11 und 12 fertig gebaute Objekte den Prozeßkammern entnommen werden und ein neuer Bauvorgang vorbereitet wird. Bei einem Aufbau gemäß Fig. 4 leitet hierzu die Umschalteinrichtung 22 die Strahlung der den Prozeßkammern 13 und 14 zugeordneten Umschalteinrichtung 222b zu. Die Umschalteinrichtung 222b führt dann die Strahlung alternierend jeder der beiden Prozeßkammern 13 und 14 zu. Insbesondere wird in der einen Prozeßkammer eine zuvor aufgetragene Schicht belichtet, während zeitgleich in der anderen Prozeßkammer auf eine zuvor selektiv belichtete Schicht eine neue Schicht aufgetragen wird.

Die Umschalteinrichtungen 22, 222a bzw. 222b sind wie bereits bei der ersten Ausführungsform beispielsweise als schaltbare optische Elemente oder als Strahlweichen ausgeführt. Im letzteren Fall besteht dann zwischen der Strahlweiche 22 und dem Laser 21 einerseits und der Strahlweiche 222a bzw. 222b andererseits eine feste Verbindung über eine Lichtleitfaser oder ein Lichtleitkabel.

In einer weiteren Abwandlung sind mehr als vier Prozeßkammern und entsprechend dazu Umschalteinrichtungen vorgesehen.

Die beiden oben beschriebenen Ausführungsformen weisen ferner den Vorteil auf, daß in den unterschiedlichen Prozeßkammern voneinander verschiedene Werkstoffpulver verwendet werden können. Ferner können zwei Chargen unmittelbar nacheinander produziert werden.

Die Erfindung ist bevorzugt anwendbar für das selektive Lasersintern bzw. das selektive Laserschmelzen, bei dem als zu verfestigendes Material ein Pulver verwendet wird. Sie ist aber nicht darauf beschränkt, sondern umfaßt auch die Verwendung eines flüssigen, lichthärtbaren Harzes, wie es aus der Stereolithographie bekannt ist oder die Verfestigung eines Pulvermaterials mittels Einwirkung eines Binders oder Binder-systems. Der Strahl besteht dabei aus Partikeln eines oder mehrerer Komponenten, der die Pulverkörner des Aufbaumaterials miteinander verbindet.

Außer der in den Ausführungsbeispielen beschriebenen Anzahl von Prozeßkammern kann auch jede beliebige Anzahl von Prozeßkammern bzw. Baubereichen oder Kombination der Anzahl der Strahlungsquellen und der zugehörigen Prozeßkammern bzw. Baubereichen vorgesehen sein. In den Prozeßkammern können verschiedene Werkstoffe, Prozeßbedingungen, wie z.B. Temperatur oder Druck oder umgebende Atmosphäre, oder Parameter wie z.B. die Laserleistung verwendet werden.

PATENTANSPRÜCHE

1. Vorrichtung zum schichtweisen generativen Herstellen von dreidimensionalen Objekten unter Einwirkung von elektromagnetischer oder Teilchenstrahlung an den jeweiligen, dem Querschnitt des Objekts in der jeweiligen Schicht entsprechenden Stellen mit

wenigstens zwei voneinander getrennten Baubereichen (11, 12) für herzustellende Objekte;

einer Strahlungsquelle (21) zum Abgeben der elektromagnetischen oder der Teilchenstrahlung,

gekennzeichnet durch

eine Umschalteinrichtung (22, 222a, 222b) zum Umschalten der Strahlung zwischen den Baubereichen, derart, daß jeweils ein Baubereich bestrahlt wird, wobei die Umschalteinrichtung (22, 222a, 222b) ein schaltbares optisches Element oder eine Strahlweiche aufweist.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Baubereiche in getrennten Prozeßkammern (11, 12) vorgesehen sind.

3. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß zum Einkoppeln und Auskoppeln der Strahlung optische Fasern mit der Umschalteinrichtung (22, 222a, 222b) verbunden sind.

4. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, gekennzeichnet durch eine Steuereinrichtung, welche die Umschalteinrichtung derart steuert, daß während eines Prozessschritt in einem Baubereich (11), der ohne Beteiligung der Strah-

lungsquelle abläuft, in einem anderen Baubereich (12) ein Prozeßschritt mit Beteiligung der Strahlungsquelle abläuft.

5. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 4, gekennzeichnet durch eine Steuereinrichtung für die Umschalteinrichtung (22, 222a, 222b), die so ausgebildet ist, daß während der Verfestigung einer Schicht in dem einen Baubereich (11) in einem anderen Baubereich (12) andere Prozeßschritte wie z.B. Schichtauftrag, Beladen oder Entladen stattfinden.

6. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß mehr als zwei Baubereiche (11, 12, 13, 14) vorgesehen sind, die entweder getrennten Prozeßkammern und/oder Teilbereichen von Mehrfachkammern zugeordnet sind.

7. Vorrichtung nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, daß wenigstens eine weitere Umschalteinrichtung (222a, 222b) vorgesehen ist, die die Strahlung zwischen den Baubereichen einer Mehrfachkammer umschaltet.

8. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 2 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daß wenigstens eine Prozeßkammer hermetisch dicht ausgebildet ist.

9. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 2 bis 8, dadurch gekennzeichnet, daß die Prozeßkammer eine Heiz- oder eine Kühleinrichtung aufweist.

10. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, daß die Strahlungsquelle als Laser ausgebildet ist.

11. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, daß die Strahlungsquelle als Quelle zum Erzeugen eines Strahls an Partikeln eines Bindermaterials ausgebildet ist.

12. Verfahren zum schichtweisen generativen Herstellen von dreidimensionalen Objekten unter Einwirkung elektromagnetischer oder Teilchenstrahlung an den jeweiligen dem Querschnitt des Objekts in der jeweiligen Schicht entsprechenden Stellen

dadurch gekennzeichnet, daß während eines Prozeßschrittes in einem Baubereich (11), der ohne Beteiligung der Strahlung abläuft, in einem anderen Baubereich (12) ein Prozeßschritt mit Beteiligung der Strahlung stattfindet, wobei die Strahlung zwischen den Baubereichen mittels einer Umschalteinrichtung, die ein schaltbares optisches Element und/oder eine Strahlweiche aufweist, umgeschaltet wird.

13. Verfahren nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, daß der Prozeßschritt mit Beteiligung der Strahlung ein Schritt des Verfestigens einer Schicht eines Aufbaumaterials mittels der Strahlung ist.

14. Verfahren nach Anspruch 12 oder 13, dadurch gekennzeichnet, daß der Prozeßschritt ohne Beteiligung der Strahlung einen Schichtauftrag, die Entnahme eines fertigen Objekts aus dem Baubereich oder Vorbereitungshandlungen für einen neuen Bauvorgang umfaßt.

15. Verfahren nach einem der Ansprüche 12 bis 14, bei dem die Objekte in einer Mehrzahl von Prozeßkammern (11, 12, 13, 14) hergestellt werden.

16. Verfahren nach Anspruch 15, bei dem die Anzahl der Prozeßkammern in zwei Gruppen unterteilt ist, wobei in der einen Gruppe von Prozeßkammern fertige Objekte den Prozeßkammern entnommen werden und/oder Prozeßkammern für einen Herstellungsvorgang vorbereitet werden, während in der anderen Gruppe von Prozeßkammern in einem Teil der Prozeßkammern eine Bestrahlung stattfindet und gleichzeitig in dem anderen Teil der Prozeßkammern ein Vorgang ohne Beteiligung der Strahlungsquelle stattfindet.

17. Verfahren nach Anspruch 16, bei dem nach Beendigung der Herstellungsvorbereitung in der einen Gruppe von Prozeßkammern in dieser Gruppe in einem Teil der Prozeßkammern dieser Gruppe eine Bestrahlung stattfindet und gleichzeitig in dem anderen Teil der Prozeßkammern dieser Gruppe ein Prozeßschritt des Vorbereitens einer Schicht stattfindet, während in der anderen Gruppe von Prozeßkammern fertige Objekte den Prozeßkammern entnommen werden oder Prozeßkammern für einen Herstellungsvorgang vorbereitet werden.

18. Verfahren nach einem der Ansprüche 12 bis 17, bei dem bei der Umschalteinrichtung die Einkopplung und Auskopplung der Strahlung mittels optischer Fasern stattfindet.

Fig. 1

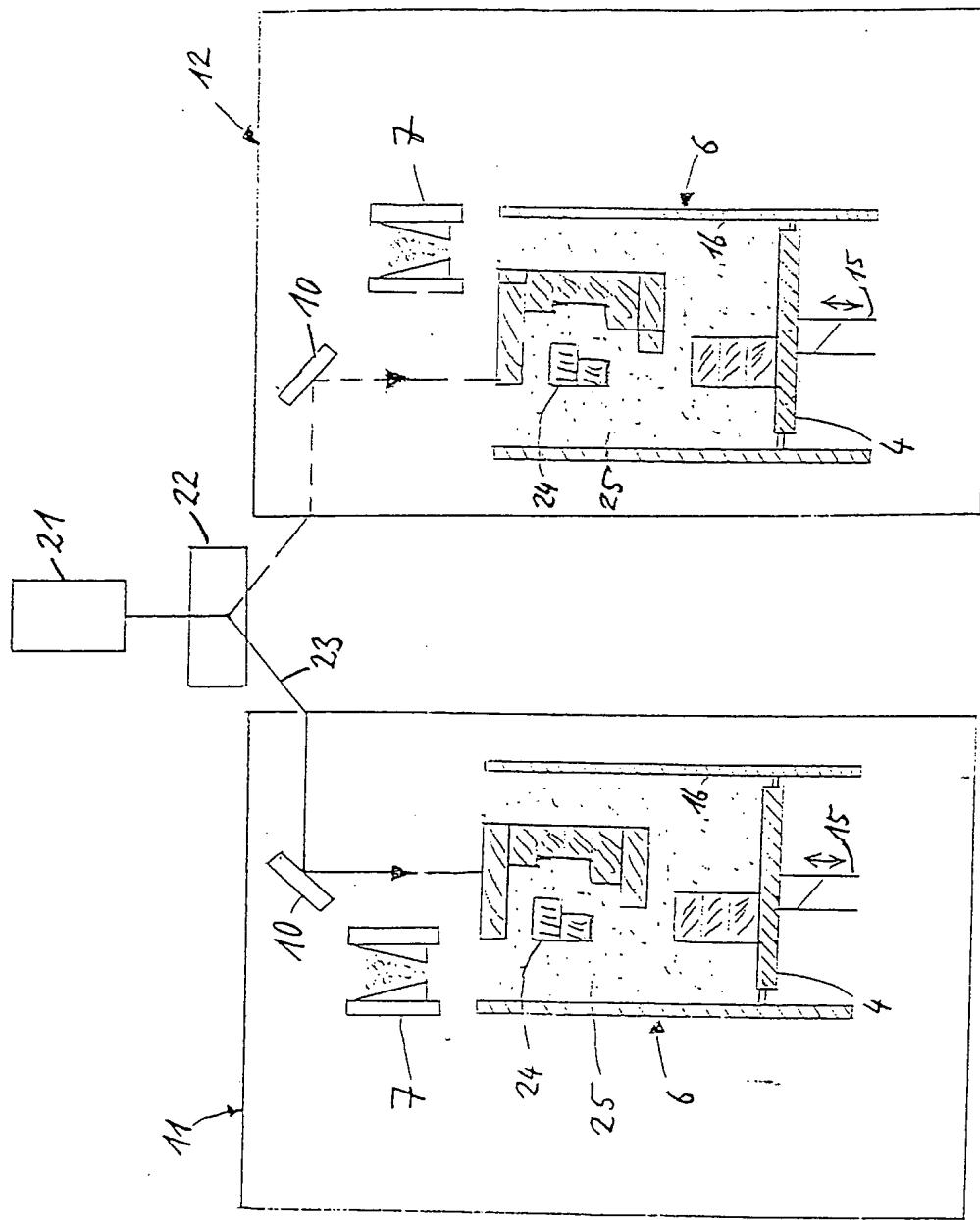


Fig 2

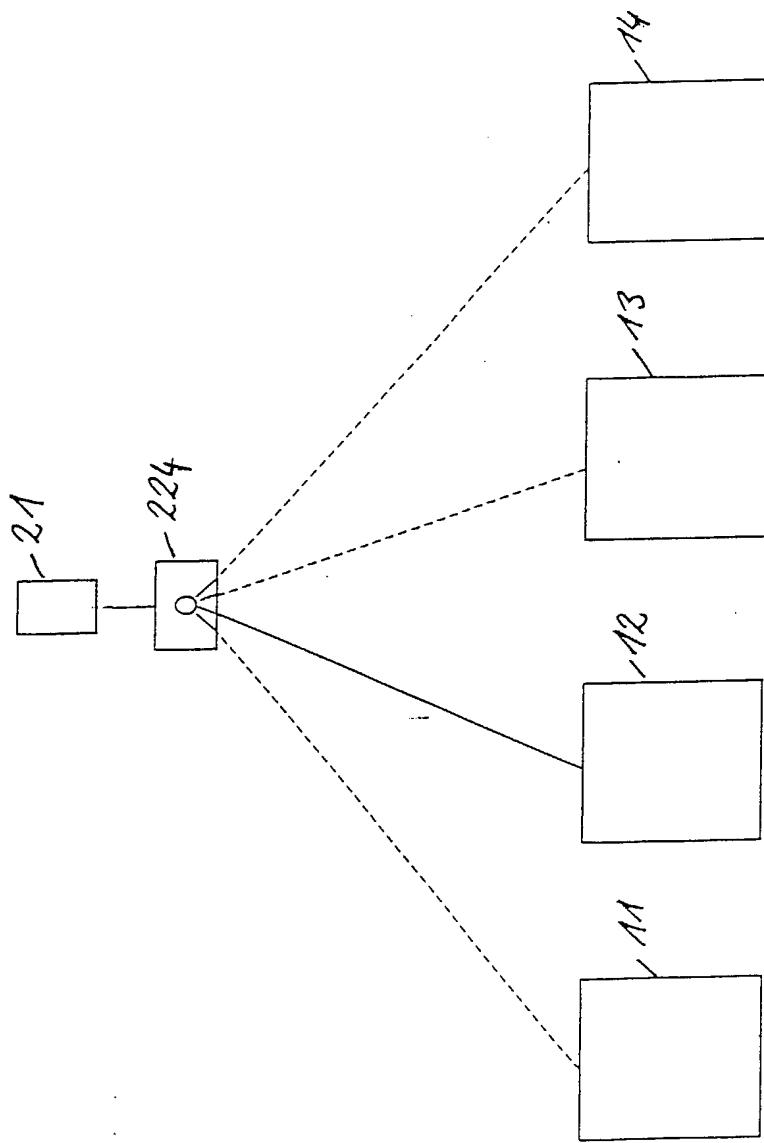
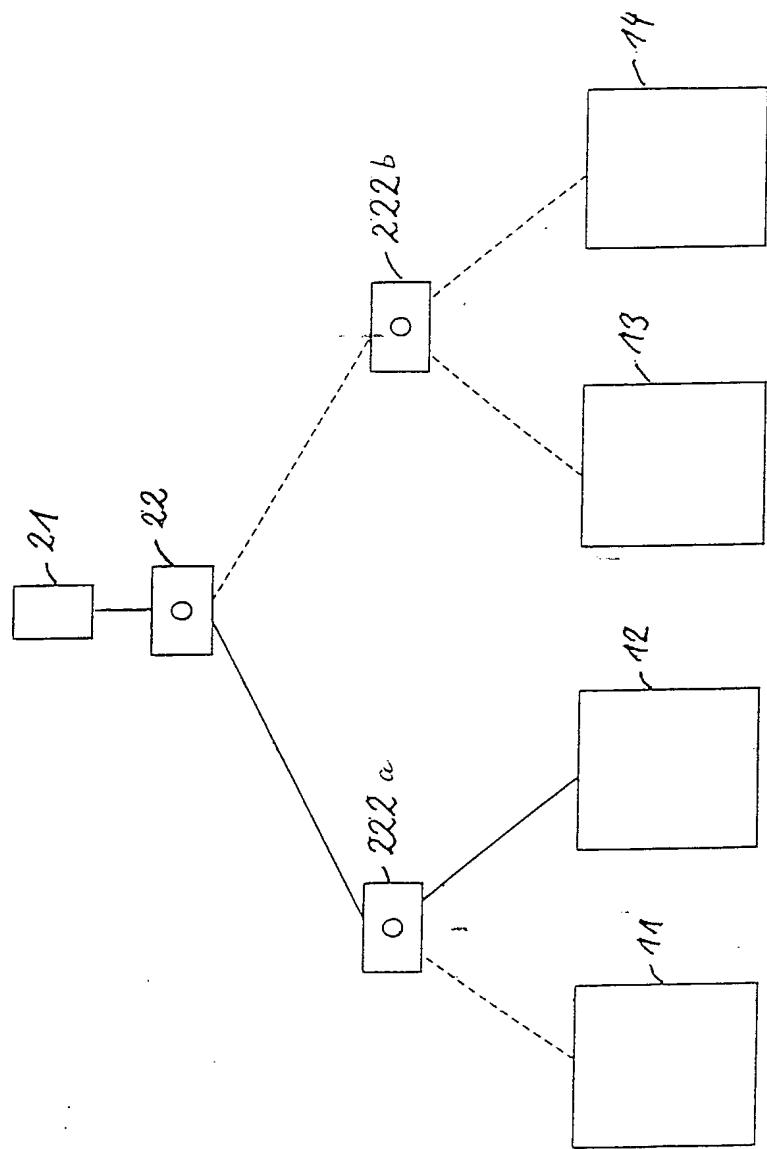


Fig 3



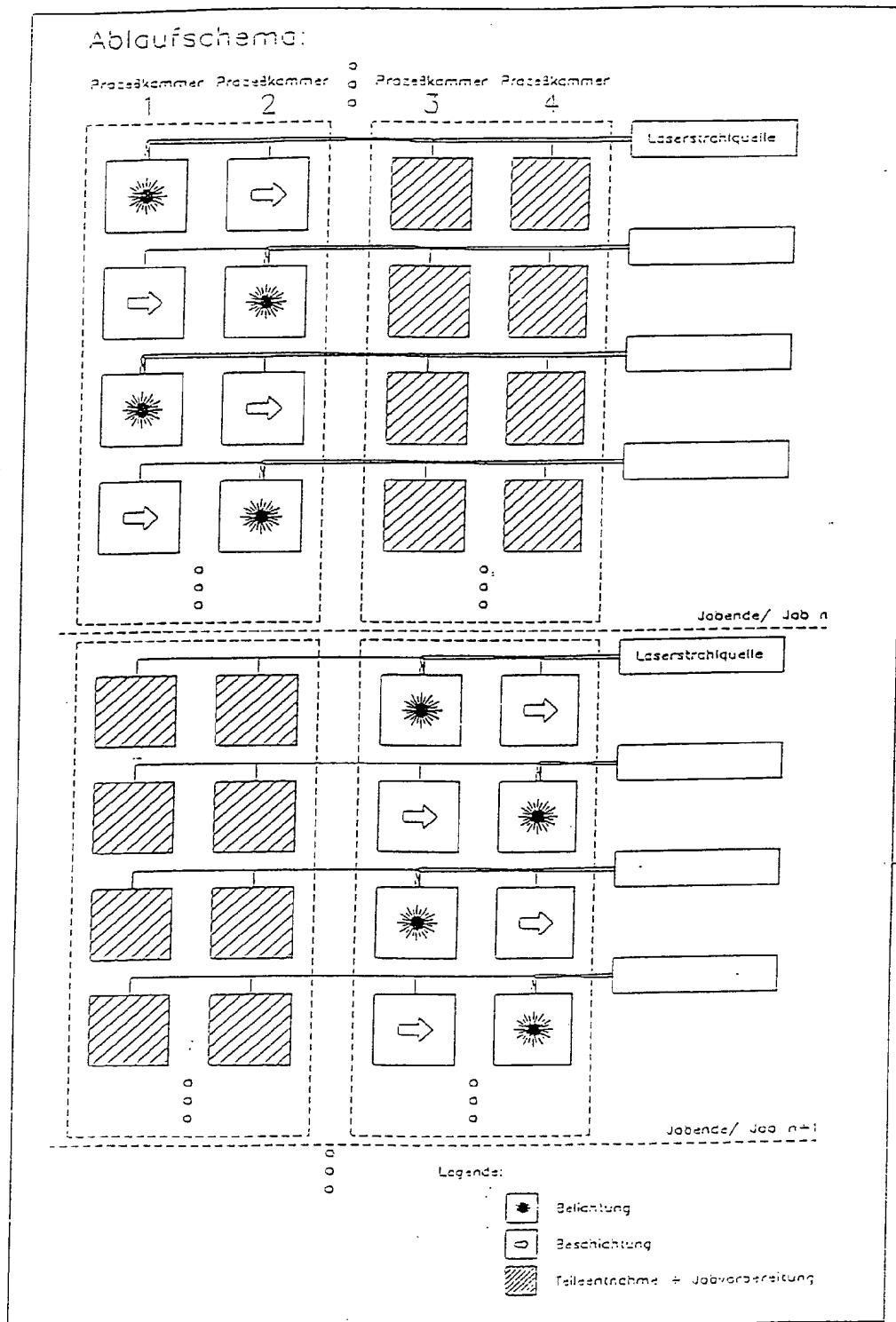


Fig. 4

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No
PCT/EP 03/07536

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER
IPC 7 B29C67/00

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)
IPC 7 B29C B22F

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the International search (name of data base and, where practical, search terms used)

EPO-Internal, WPI Data, PAJ

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
P, X	EP 1 316 408 A (CONCEPT LASER GMBH) 4 June 2003 (2003-06-04) paragraph '0008!; figure 1 paragraph '0018! – paragraph '0019!; figures 4,5 ---	1,2,4,5, 10,12-15
X	DE 299 07 262 U (EOS ELECTRO OPTICAL SYST) 15 July 1999 (1999-07-15)	1,4,10, 12,13
Y	page 3, line 21 – line 33 page 6, line 11 – line 25 page 7, line 19 – line 31; figure 1 ---	2,8,9,15
Y	DE 199 52 998 A (EBERT ROBBY ;EXNER HORST (DE)) 17 May 2001 (2001-05-17) column 6, line 56 -column 8, line 14; figure 2 ---	2,15 -/-

Further documents are listed in the continuation of box C

Patent family members are listed in annex

* Special categories of cited documents :

- *A* document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
- *E* earlier document but published on or after the international filing date
- *L* document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
- *O* document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
- *P* document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

- *T* later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
- *X* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
- *Y* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.
- *&* document member of the same patent family

Date of the actual completion of the International search

22 October 2003

Date of mailing of the International search report

28/10/2003

Name and mailing address of the ISA

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax: (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Pierre, N

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No
PCT/EP 03/07536

C.(Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Y	DE 101 08 612 C (DAIMLER CHRYSLER AG) 27 June 2002 (2002-06-27) paragraph '0013! - paragraph '0016!; claim 5 -----	9
Y	US 5 306 447 A (LIN SHYH-NUNG ET AL) 26 April 1994 (1994-04-26) column 9, line 54 -column 10, line 16; figure 1 -----	8

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International Application No

PCT/EP 03/07536

Patent document cited in search report		Publication date		Patent family member(s)		Publication date
EP 1316408	A	04-06-2003	DE EP	10158169 A1 1316408 A1		18-06-2003 04-06-2003
DE 29907262	U	15-07-1999	DE	29907262 U1		15-07-1999
DE 19952998	A	17-05-2001	DE	19952998 A1		17-05-2001
DE 10108612	C	27-06-2002	DE EP US	10108612 C1 1236526 A1 2002158054 A1		27-06-2002 04-09-2002 31-10-2002
US 5306447	A	26-04-1994	US US US AU EP JP WO AU WO WO	5017317 A 5135695 A 5169579 A 7160891 A 0589869 A1 5504377 T 9109149 A1 1583592 A 9216343 A1 9302846 A1		21-05-1991 04-08-1992 08-12-1992 18-07-1991 06-04-1994 08-07-1993 27-06-1991 21-10-1992 01-10-1992 18-02-1993

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP 03/07536

A. KLASSEFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES

IPK 7 B29C67/00

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierte Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)

IPK 7 B29C B22F

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal, WPI Data, PAJ

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
P, X	EP 1 316 408 A (CONCEPT LASER GMBH) 4. Juni 2003 (2003-06-04) Absatz '0008!; Abbildung 1 Absatz '0018! - Absatz '0019!; Abbildungen 4,5 ---	1,2,4,5, 10,12-15
X	DE 299 07 262 U (EOS ELECTRO OPTICAL SYST) 15. Juli 1999 (1999-07-15)	1,4,10, 12,13
Y	Seite 3, Zeile 21 - Zeile 33 Seite 6, Zeile 11 - Zeile 25 Seite 7, Zeile 19 - Zeile 31; Abbildung 1 ---	2,8,9,15
Y	DE 199 52 998 A (EBERT ROBBY ;EXNER HORST (DE)) 17. Mai 2001 (2001-05-17) Spalte 6, Zeile 56 -Spalte 8, Zeile 14; Abbildung 2 ---	2,15 -/-

Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen

Siehe Anhang Patentfamilie

- * Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :
- *A* Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist
- *E* älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist
- *L* Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)
- *O* Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht
- *P* Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

- *T* Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist
- *X* Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erforderlicher Tätigkeit beruhend betrachtet werden
- *Y* Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erforderlicher Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann nahelegend ist
- *&* Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

22. Oktober 2003

Absendedatum des internationalen Recherchenberichts

28/10/2003

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde
Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax: (+31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Bediensteter

Pierre, N

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP 03/07536

C.(Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
Y	DE 101 08 612 C (DAIMLER CHRYSLER AG) 27. Juni 2002 (2002-06-27) Absatz '0013! - Absatz '0016!; Anspruch 5 ----	9
Y	US 5 306 447 A (LIN SHYH-NUNG ET AL) 26. April 1994 (1994-04-26) Spalte 9, Zeile 54 -Spalte 10, Zeile 16; Abbildung 1 -----	8

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP 03/07536

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument		Datum der Veröffentlichung		Mitglied(er) der Patentfamilie		Datum der Veröffentlichung
EP 1316408	A	04-06-2003	DE EP	10158169 A1 1316408 A1		18-06-2003 04-06-2003
DE 29907262	U	15-07-1999	DE	29907262 U1		15-07-1999
DE 19952998	A	17-05-2001	DE	19952998 A1		17-05-2001
DE 10108612	C	27-06-2002	DE EP US	10108612 C1 1236526 A1 2002158054 A1		27-06-2002 04-09-2002 31-10-2002
US 5306447	A	26-04-1994	US	5017317 A 5135695 A 5169579 A 7160891 A 0589869 A1 5504377 T 9109149 A1 1583592 A 9216343 A1 9302846 A1		21-05-1991 04-08-1992 08-12-1992 18-07-1991 06-04-1994 08-07-1993 27-06-1991 21-10-1992 01-10-1992 18-02-1993